

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐其他
-----------	--

	品牌客户中的渗透率，以及积极挖掘高增长蓝海市场等举措，不断夯实核心竞争力。从当前发展态势来看，上述增长因素对公司上半年经营的积极影响仍在持续释放，业绩增长的良好势头有望得到延续。 Q2：公司专注的市场以及接下来的增长动力是什么？ 答：炬芯聚焦于端侧 AI 技术在音频领域的深度落地与创新应用。我们认为，随着 AIoT 生态的蓬勃发展，海量智能设备对专用 AI 模型的部署需求正呈爆发式增长，这其中蕴藏着不可限量的市场机遇。为精准响应这一需求，炬芯推出的新一代产品采用 CPU+DSP+NPU 三核异构架构。其中，作为核心 AI 加速引擎的 NPU，采用基于 SRAM 的模数混合存内计算技术打造，可以在更小的面积、更低的功耗和更优的成本控制下，释放出澎湃且高效的 AI 算力，实现了“能效比”的跨越式提升，为端侧 AI 应用和公司发展注入强劲动力。据第三方专业咨询机构的权威预测，端侧 AI 市场正迎来黄金增长期：预计到 2028 年，搭载中小型模型的端侧 AI 设备出货量将突破 40 亿台，年复合增长率高达 32%；而到 2030 年，全球 75% 的 AIoT 设备将全面采用高能效比专用硬件方案。炬芯将持续深耕端侧 AI 音频赛道，与客户共同把握端侧 AI 的增长机遇。 Q3：公司第一代三核架构的芯片产品，目前客户导入的进展如何？ 答：公司已正式发布最新一代基于 SRAM 的模数混合存内计算的端侧 AI 音频芯片，采用 CPU+DSP+NPU 三核异构架构，可在更低功耗下提供更高算力，同时兼具更低的延迟和增强的安全性，将在音频应用和端侧 AI 中发挥重要作用。产品共包括三个芯片系列：第一个系列是 ATS323X，面向低延迟高音质私有无线音频领域；第二个系列是 ATS286X，面向蓝牙 AI 音频领域；第三个系列是 ATS362X，面向端侧 AI 处理器领域。目前，ATS323X 已搭载于品牌客户无线麦克风产品中上市发售并快速放量。ATS286X、ATS362X 客户产品导入持续推进中，将会有产品陆续上市销售。 Q4：如何展望今年新产品贡献营收的趋势，对于公司 ASP 拉动的影响？ 答：公司基于三核异构架构的芯片采用了更加先进的工艺制程和存内计算技术，相较公司现有产品可以在现有功耗水平下提供几十倍至上百倍的算力提升，而相较于市场上主流的 NPU 产品能效比可以提升至少三倍以上，
--	--

	相较于主流的 DSP 产品在功耗方面能降低接近 90%，因此在价格上相较公司上代产品也会有十分明显的提升，今年新产品将对营收以及 ASP 持续产生正向拉动。 Q5：公司对于收并购的方向和规划是什么？ 答：收并购是国内外上市公司实现增长的一个重要途径，近期相关政策的出台也体现出监管层对上市公司使用收并购工具的支持。公司会从标的资产的协同效应、市场规模以及增长前景等多个角度对潜在的标的资产进行评估筛选，后续如涉及相关重大事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。 Q6：三核架构除了对当前的场景的应用，未来会拓展在哪些潜在的领域？ 答：在基于 SRAM 的模数混合存内计算技术路径下的端侧 AI 芯片平台具有非常广阔的应用前景，主要可以覆盖语音与音频、视觉识别以及健康类监测等相关应用场景，并且可实现端侧 AI 解决方案的快速落地。公司也将积极打造 AI 开发生态，借助炬芯完整工具链轻松实现算法的融合，帮助客户迅速地完成产品落地，助力 AIoT 产品 AI 化的不断演进。 Q7：接下来一段时间，研发投入的方向以及相关人员费用的规划是什么？ 答：技术研发是公司业绩增长的重要驱动力，公司很高兴看到技术研发投入与营收规模提升保持着正向循环，2024 年公司研发支出 2.15 亿元，占营收比例约 33%，公司主要取得了三个方面的研发成果，第一是基于 CIM 技术打造了炬芯第一代三核异构架构的芯片平台，第二是发布了 ANDT 开发工具链，可以助力客户模型的快速部署，打造端侧 AI 高效开发生态环境，第三是持续升级拓展无线连接技术，低延迟高音质各项指标达到了业界先进水平。接下来一段时间，公司的研发投入方向也将继续围绕低功耗大算力、开发生态和无线连接三个方向拥抱端侧 AI 海量的芯片需求。 Q8：公司存算技术后续的路线迭代是什么计划？ 答：在存内计算（CIM）技术迭代上，包括制程节点、关键性能指标等方面，公司都有清晰的路线规划，目前已着手第二代 CIM 技术的相关 IP 研发工作，目标是将 NPU 单核算力提升三倍至 300GOPS，并直接支持 Transformer 模型，将能效比提高至 7.8TOPS/W@INT8。
--	---

	Q9: 公司产品在端侧 AI 落地的场景以及后续对于端侧 AI 市场的规划? 答: 公司的端侧 AI 处理器芯片当前优先应用在音频市场, 相应的场景包括人声分离、AI 智能降噪、声纹识别等, 公司发挥自身的技术优势, 可以为端侧产品提供低功耗下的 AI 算力。公司会持续打造低功耗的 AI 算力平台, 将逐步拓展至音频之外的更多场景应用, 比如运动健康方面的传感器数据 AI 处理应用等。 Q10: 针对 AI 眼镜、智能手表等智能穿戴类芯片会有新的芯片产品推出么? 答: 目前公司相关研发工作正在稳步推进中, 新一代智能穿戴芯片将采用三核架构, 搭载存内计算技术, 将为下游客户提供更具竞争力的芯片平台与产品解决方案。
是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 08 月 11 日